

石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー
プリント基板の熱設計ガイドラインに基づく
基板放熱設計の課題と対策について

開催のご案内

主催：公益財団法人 石川県産業創出支援機構
協力：石川県工業試験場

電子機器の小型化・高機能化に伴い熱設計の重要度が増す中、1W未満程度の低発熱チップ部品では、基板の放熱不足による過剰な温度上昇が問題となっています。JEITAサーマルマネージメント標準化グループでは、基板の効率的な放熱の熱設計について提案活動を進め2020年末に“基板放熱型部品を実装したプリント基板の熱設計ガイドライン”を刊行しました。

そこで、本ガイドの内容に基づき、基板の放熱設計の課題と対策について紹介します。

[日 時] 令和4年6月24日（金） 13:30～15:00

[形 式] ZoomによるWeb配信【お申込みされたe-mailに接続先URLを送信します。】

[講 師] KOA株式会社 技術イニシアティブ技創りセンター

有賀 善紀 氏

[受講料] 無料

[定 員] 20名

[担 当] 石川県工業試験場 電子情報部 専門研究員 的場彰成

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地（石川県工業試験場 企画指導部内）

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 プロジェクト推進部 次世代講座担当

e-mail: seminar@iriii.jp

TEL: (076) 267-8081 FAX: (076) 267-8090

[締切り] 令和4年6月17日（金）（定員になり次第締切ります。）

受講ご希望の方は、e-mailにて下記の項目を記載してお申込みください。FAXの場合は、この用紙をご利用ください。またQRコードからもお申込みできます。

【セミナー名】 「プリント基板の熱設計ガイドラインに基づく
基板放熱設計の課題と対策について」



【会社名】

【住 所】 〒

【受講者名】

【所属・役職】

【TEL】

【FAX】

【e-mail】